

# 46-956 / 46-957 Economy Version

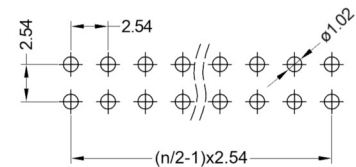
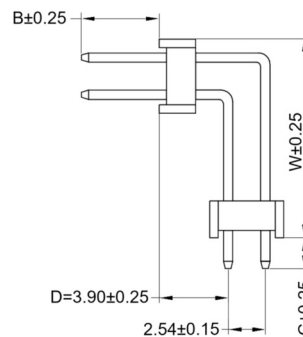
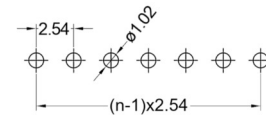
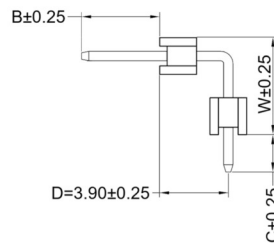
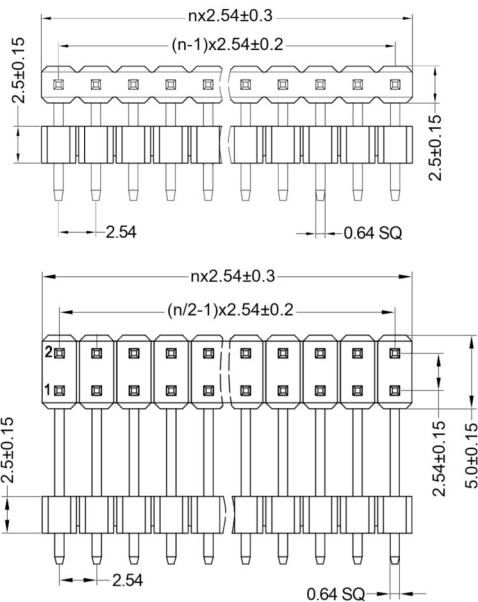
Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig  
Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row

## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.64mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	20 mΩ max.
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	1000 MΩ min.
Insulation Resistance	1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	1000 V AC/DC
Test Voltage	1000 V AC/DC
Nennstrom	3.0 A
Current Rating	3.0 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)



Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
153 154 46-157 46-159 46-160 / 46-162 46-624 etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



Recommended P.C.B Layout (Top Side)  
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

### Series\*

**46-956**

**46-956** Einreihig  
Single row  
**46-957** Zweireihig  
Double row

### Dimensions\*

**12**

**12** B=4.60 C=3.30 D=3.9 W=13.50mm  
**13** B=4.80 C=3.30 D=3.9 W=16.80mm  
**99**- Kundenspezifisch  
Customer-specific

### Contacts\*

**016**

**001-020** Einreihig  
Single row  
**004-050** Zweireihig  
Double row

### Plating

**00**

**00** Vergoldet  
Gold plated

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb $T_L$	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	Lower Temperature [°C]
Duration above $T_L$	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

